## 特集Ⅱ/先端から基盤までを支える粉体工学の進歩

# 微粒子複合化・構造制御とその応用展開

## Particle Composite and Microstructure Control Process, and Their Application

# 多々見 純一<sup>1</sup>, 中野 裕美<sup>2</sup> Junichi TATAMI, Hiromi NAKANO

1 横浜国立大学,2 豊橋技術科学大学 Yokohama National University,Toyohashi University of Technology

#### Abstract

A mechanical particle composite process was applied to develop several kinds of advanced ceramics. Nanoparticles were stuck on a larger particles and they were well dispersed in powder mixtures. In most cases, microstructure of the developed advanced ceramics was very uniform. CNT-TiO<sub>2</sub> nanocomposite particles for electrically conductive CNT-dispersed Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ceramics from, AlN-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanocomposite particles for AlN ceramics having highly electrical insulation, ZnO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanocomposite particle for ZnO ceramics with highly electrical conductivity, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-carbon black nanocoposite particles for pore size and morphology-controlled porous Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramics, and BaCO<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub> nanocomposite particles for synthesis of tetragonal BaTiO<sub>3</sub> nanoparticles having highly crystallinity were prepared by the mechanical particle composite process. It was shown that the mechanical particle composite process is very effective in the microstructure control and improvement of many kinds of properties of advanced ceramics.

### 1. はじめに

金属、セラミックス、高分子およびこれらの複合材料の多くが、粉体を利用して作製されている。このような材料の特性は、原子間の結合や結晶構造だけでなく、粒径、粒界、不純物、第二相粒子、気孔、欠陥などの微構造に依存する。特に、粉体を原料として製造される材料においては、後者の微構造因子が粉体プロセスから強く影響を受ける。すなわち、粉体の構造と存在状態の制御が、材料の高機能・多機能化のキーポイントとなる。例えば、材料中にナノ粒子という不均質構造を積極的に導入したナノコンポジット材料は、ミクロスケールのコンポジットと比較して優れた特性を有することが知られており、ナノ粒子の分散による新機能の発現・機能の多重化も可能になる。しかし、ナノ粒子を凝集した状態で添加しても、得られる材料の特性は粗大な粒子を添加したものと同じかそれ以下

となってしまい、ナノ粒子添加のメリットを得ることはできない。粉体による材料構造制御を実現する重要な手法の一つが、微粒子複合化である<sup>1)2)</sup>。本稿では、これまでに我々が行ってきた先進セラミックスについての機械的処理による微粒子の複合化と構造制御について、いくつかの実例を挙げながら報告する。

# 2. 機械的処理によるナノ複合粒子の調製と セラミックスへの応用

### 2.1 CNT分散導電性Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>セラミックス

窒化ケイ素( $Si_3N_4$ )セラミックスは機械的特性、化学的安定性に優れた材料であり、ベアリングなどへ応用されている $^3$ )。近年、絶縁体である $Si_3N_4$ セラミックスにカーボンナノチューブ(CNT)を分散させることにより導電性を付与する研究が注目されている $^4$ )が、所望の特性を発現するためにはCNT の分散

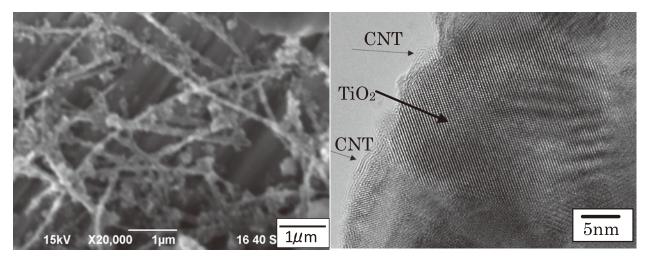


図1 機械的処理で調製した TiO2-CNT ナノ複合粒子の SEM および TEM 写真

がキープロセスとなる。これを受けて、我々は機械的 粒子複合化により  $Si_3N_4$ セラミックスの焼結助剤の一 つである  $TiO_2$ 粒子と CNT からなる複合粒子を調製 し、これを用いて CNT 分散  $Si_3N_4$ セラミックスを作 製した $^{5)}$ 。

まず,粒径20nmの  $TiO_2$ と CNT を  $TiO_2$ : CNT=10:1 および 5:1 の重量比で秤量した。これらの原料粉体を,機械的粒子複合化装置(ノビルタ NB-130(ホソカワミクロン(㈱製))を用いて,1.5kw,10分保持の条件で機械的処理を行った。複合粒子の微構造観察の結果,CNT は  $TiO_2$ と複合粒子を形成して良好に分散していることが確認された(図 1)。

この複合粉体を用いて、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、TiO<sub>2</sub>、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、  $Al_2O_3$ , AlN が重量比で92:5:5:3:5, CNT が 外掛けで0.5、1.0wt%となるように、エタノール中で 湿式混合した。スラリーを乾燥して得られた造粒粉体 を用いて、一軸成形及び CIP 成形にて成形体を作製 した。脱脂した成形体を0.9 MPa N。雰囲気下にて1700 ~1800℃, 2 h の条件でガス圧焼結した。さらに100 MPa N₂雰囲気下, 1700℃, 1 h の条件で HIP 処理を 施した。焼結体の相対密度はいずれも95%以上とな り、緻密な焼結体を得ることができた。導電率測定の 結果, CNT が0.5wt%の試料では導電性は発現しなか ったが、1.0wt%の試料では2.8~6.5 S/m の導電率を 有し、焼結温度が高いほど高い導電率を示した。 SEM による微構造観察の結果、多くの CNT が Si<sub>2</sub>N<sub>4</sub> セラミックス中に残存しており(図2),これらが導 電パスとなったと考えられる。また、曲げ強度と破壊 靱性は湿式プロセスで作製したものとほぼ同程度の値 となった。すなわち、乾式プロセスである機械的粒子

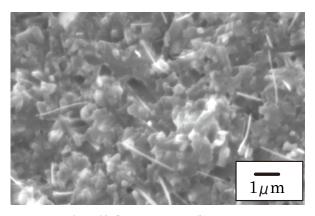


図 2 1700℃で焼成した CNT 分散 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>セラミック スの破面の SEM 写真(CNT1wt%)

複合化により従来の湿式プロセスより簡便に CNT 分散 Si<sub>2</sub>N<sub>4</sub>セラミックスを作製できることが分かった。

#### 2.2 AINセラミックスの電気抵抗制御

AIN セラミックスは高い熱伝導率を活かして、放 熱用絶縁基板などに応用されている $^{5)}$ 。このような AIN セラミックスは、 $Y_2O_3$ などの焼結助剤を添加した液相焼結で緻密化が図られる。特性向上のためには、均質な微構造を実現することが必須であるが、このためには焼結助剤の均一分散が不可欠である。そこで、機械的処理により AIN- $Y_2O_3$ ナノ複合粒子を調製し $^{6)}$ 、これを用いた AIN セラミックスの作製を試みた。 原料料 エトー て真独 味みの微細な AIN 料本 ト エカ

原料粉末として高純度かつ微細な AlN 粉末と平均 粒径50nm の高純度  $Y_2O_3$ 粉末を用いた。これらの粉末を 1 wt% $Y_2O_3$ となるように湿式混合でプレミックスした後,機械的粒子複合化装置(ホソカワミクロン(株): NOB-130)によりナノ複合粒子を調製した。こ

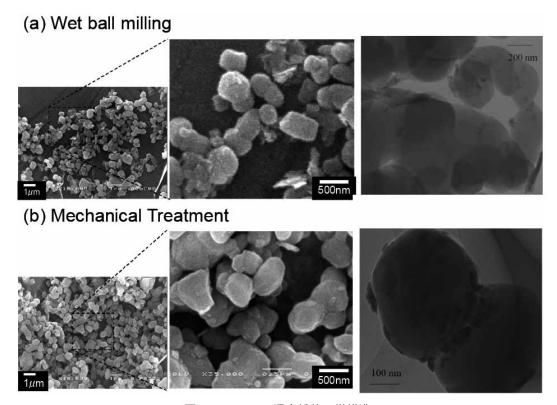


図3 AIN-Y2O3混合粉体の微構造

れを用いて作製した成形体を  $N_2$ 雰囲気0.6MPa, 1650  $\sim 1850$   $\mathbb{C}$ , 2 h の条件で焼成した。また、ボールミルによる湿式混合のみを行った試料も同様に焼結体を作製して評価した。

SEM および TEM 観察の結果、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ナノ粒子は AIN 表面に接合して均一に分散して存在しているこ とがわかった(図3)。このようなナノ複合粒子を用 いて作製した AIN セラミックスの構成相は、焼成温 度と混合プロセスによらず AIN と YAG であった。 AIN セラミックス中に存在する第2相の YAG の粒径 は、ボールミルでは広い分布を有しているのに対し て、粒子複合化プロセスでは均一かつ微細に分散して いた(図4)。AIN セラミックスの相対密度と熱伝導 率は焼成温度の上昇とともに増加したが、ボールミル と粒子複合化プロセスでほぼ同じ値であった。一方. 体積抵抗率は、いずれの焼成温度でもボールミルより も機械的粒子複合化プロセスの方が高い値となった。 これは、粒子複合化プロセスにおいて第2相のYAG が微細かつ均一に分散していることに起因していると 推測される。

#### 2.3 ZnOセラミックスの導電率制御

ZnO は優れた電気的,力学的,光学的特性を活か

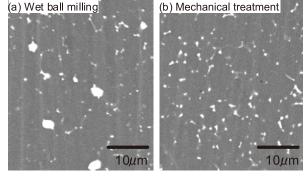


図 4 AIN セラミックスの微構造(反射電子像(組成 像))

して、多くの分野に応用されている機能性材料である。機能向上のために各種微量成分の添加が行われており、例えば、ZnOへの  $Al_2O_3$ の添加は導電率の向上に効果的である。これを受けて我々は、機械的粒子複合化プロセスにより調製した  $Al_2O_3$ ナノ粒子 /ZnO 複合粒子を用いて ZnO セラミックスを作製し、電気的特性や微構造に及ぼす  $Al_2O_3$ 添加量と粉末調製プロセスの影響について検討した $^{7}$ 。

原料粉末として平均粒径 7 nm の  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>と平均粒径400nm の ZnO を 用 い た。 本 実 験 で は,ZnO と Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の混合比が 1:0.01及び0.001mol となるように

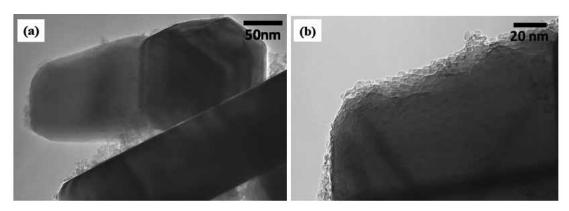


図 5 機械的処理で調製した ZnO-Al₂O₃ナノ複合粒子の TEM 写真((b)は(a)の拡大図)

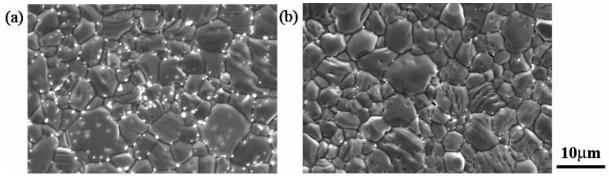


図 6 1.0mol%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>添加 ZnO セラミックスの微構造 (a) ボールミル (b) 機械的処理

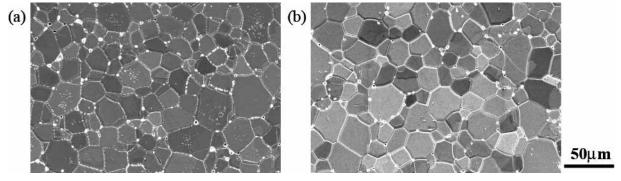


図 7 0.1mol%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>添加 ZnO セラミックスの微構造 (a) ボールミル (b) 機械的処理

調整した。プレミックスとして、 $Al_2O_3$ ボールを用いた乾式混合を行った。その後、機械的粒子複合化装置(ホソカワミクロン(株)、NOB-130)により粒子複合化を行った。図 5 に機械的処理により混合を行った粉末の TEM 像を示す。寸法の大きい濃い色の粒子が ZnOである。 $\gamma$ - $Al_2O_3$ の明らかな凝集体は確認することができなかった。ZnO 粒子の表面近傍を拡大して観察した結果、図 5 (b) に示すように ZnO の表面に約10nm 程度の非常に微細な粒子が鱗状に分散している

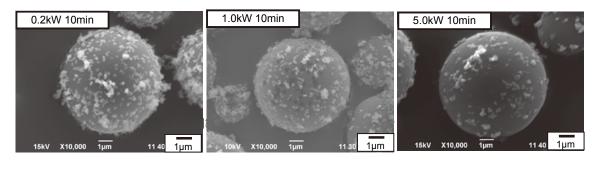
様子が確認された。添加した $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粒径が7 nm であることから,機械的処理によりZnO 粉末の表面に $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粒子が接合したことが確認できた。

得られた粉末を造粒した後,50MPa で一軸成形,200MPa で CIP 成 形 し た。 こ れ を,1400℃,5℃/min,2h,大気中の条件で焼成して焼結体を作製した。得られた焼結体の密度測定,微構造観察,および,電気特性評価を行った。また,比較試料としてエタノールによる24h のボールミル湿式混合も行った。

機械的粒子複合化および湿式ボールミルのいずれの混 合方法で作製した試料も相対密度約99%の緻密な焼 結体が得られた。図6および7に機械的粒子複合化お よび湿式ボールミルで得られた混合粉体を使用して作 製した焼結体の微構造を示す。機械的複合化処理で得 られた粉体を用いて作製した試料の方が ZnO の粒成 長が抑制されている様子が確認された。直流四端子法 にて測定した1.0mol% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 添加 ZnO セラミックス の導電率は、湿式ボールミルで333S/cm、機械的処理 で588S/cm, 0.1mol% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 添加 ZnO セラミックス の導電率は、湿式ボールミルで38.5S/cm、機械的処 理で116S/cmという結果をとなった。すなわち、い ずれの組成でも機械的処理粉末を用いた ZnO セラミ ックスの導電率は、湿式ボールミル粉末 ZnO セラミ ックスより2倍以上の高い値となることが分かった。 これは、機械的処理により Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>が ZnO 表面に均一 に分散したしたことで、 粒成長が抑制されるととも に、短時間の焼成で Al が ZnO 内に均一に拡散したこ とにより、高い導電率を得ることができたと推測され る。

#### 2.4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>多孔体の気孔構造制御

セラミックス多孔体はフィルター、電池、断熱材、 触媒担体など多岐にわたる応用がなされている。この 場合に機能発現のために重要なのは気孔構造の制御で ある。ここでは、機械的処理により調製したナノ複合 粒子を用いた Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>多孔体の気孔構造制御を行った例 を示す。球状フェノール樹脂(ベルパール R200, エ ア・/ウォーター(株製、平均粒径5.8 µm) と高純度ア ルミナ (TM-DAR, 大明化学工業㈱製, 平均粒径0.1 μm) を用いた。これらの粉体を重量比52.5:47.5 (=体積比78.0:22.0)となるように秤量した。この場 合, アルミナ粒子の断面積の総和を樹脂粒子の表面積 で除して計算して得られた被覆率は400%となる。こ れらを機械的粒子複合化装置 (ノビルタ NOB-130, ホソカワミクロン(株製) に投入し、出力0.2~5 kW, 保持時間10分の条件で処理した。図8に機械的粒子複 合化後の粒子の SEM 写真を示す。機械的粒子複合化 時の負荷が増大するほど被覆している粒子が低減して いることがわかる。これは、内藤らにより報告されて いるように、高負荷では付着した粒子の剥離が生じて いるためであると考えられる。この実験では, 0.2kW が適当であることがわかったので、この条件で作製さ



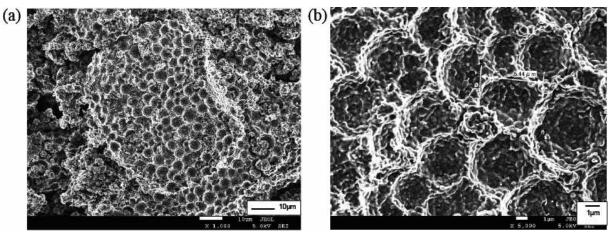


図9 ナノ複合粒子を用いて作製した Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>多孔体の SEM 写真((b)は(a)の拡大図)

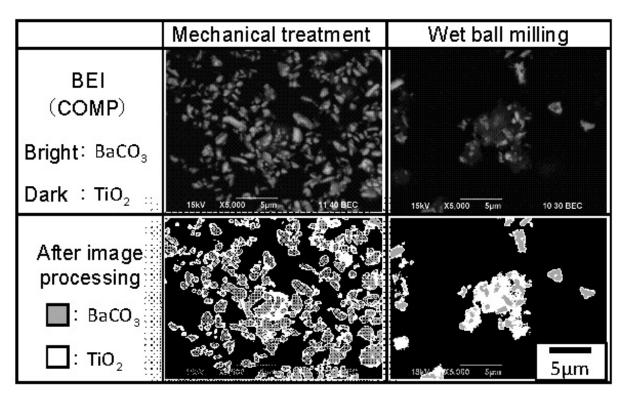


図10 機械的処理および湿式ボールミルで調製した BaCO<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub>混合粉体の SEM 写真

れた複合粒子を用いて多孔体の作製を行った。

得られた混合粉体にバインダーとしてパラフィンを添加した後,圧力50MPa の条件で一軸成形を行った。得られた成形体を大気中,昇温速度 $10^{\circ}$ C/min,最高温度 $1400^{\circ}$ C,保持時間 1 h の条件で焼成した。図9に作製されたアルミナ焼結体の SEM 写真を示す。図9(a)に示すように球状粒子が比較的規則正しく整列して多孔体を形成していることがわかる。また,図9(b)に示すように SEM 写真から観察される気孔径は約5 mm 程度であり,造孔剤が消失したことにより多孔体が作製されることが確認された。多孔体の壁の厚さは約 $0.5^{\circ}$ C 1  $\mu$ m であった。これは,被覆率が400%であることからほば妥当であると考えられる。

アルキメデス法により測定した焼結体の密度は  $1.30 \mathrm{g/cm}^3$ であった。これは相対密度はとして32.6%,気孔率67.2%に相当している。水銀ポロシメーターにより焼結体の気孔径分布を測定した結果,気孔径分布には $0.8\,\mu\mathrm{m}$ , $5.2\,\mu\mathrm{m}$ , $9.8\,\mu\mathrm{m}$  の 3 つのピークが確認された。特に, $0.8\,\mu\mathrm{m}$  の気孔が多数存在していることがわかった。前述の SEM 写真の通り,多孔体中にはフェノール樹脂に起因した  $5\,\mu\mathrm{m}$  程度の気孔が存在していた。 $5.2\,\mu\mathrm{m}$  の気孔はこれに対応していると考えられる。 $9.2\,\mu\mathrm{m}$  の気孔の起源は明確ではない

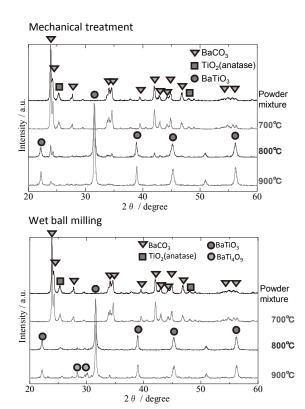


図11 原料混合粉体および種々の温度で焼成して作製 した生成物の XRD プロファイル

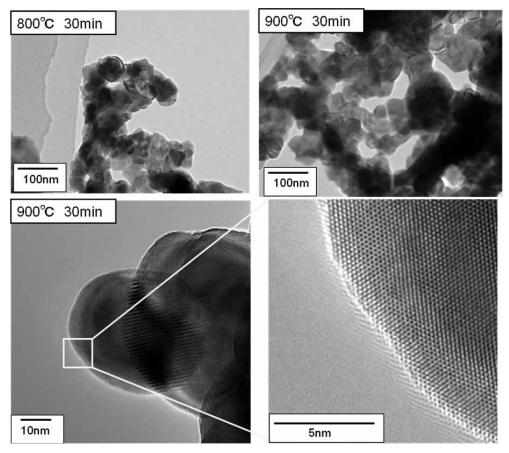


図12 ナノ複合粒子を用いて作製した BaTiO<sub>3</sub>粒子の TEM 写真

が、フェノール樹脂 2 つ分の孔に相当していることから、二つの連結した気孔に起因していると推測される。一方、 $0.8\,\mu\mathrm{m}$  の気孔は機械的粒子複合化による被覆が不十分な領域によるものと、複合粒子間の気孔に相当していると考えられる。特に後者は連続気孔を形成していると考えられることから、水銀ポロシメーターにより多数の気孔が確認されたものと考えられる。

### 2.5 BaCO<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub>系の反応制御

固相反応による物質合成は広い範囲で行われている汎用なプロセスである。固相反応はその界面で起こるが、機械的処理により調製したナノ複合粒子は粒子間で界面を形成することから、効率的な固相反応による物質合成が期待できる。 $BaTiO_3$ 積層セラミックスコンデンサの大容量化に伴う薄層化のために、微細な $BaTiO_3$ 粉体が求められている。 $BaTiO_3$ は  $BaCO_3$ と $TiO_2$ の固相反応で合成されることから、機械的処理で作製したナノ複合粒子の利用は効果的であると予想される。そこで、機械的粒子複合化プロセスにより

 $BaCO_3$ 粒子と  $TiO_2$ ナノ粒子からなるナノ複合粒子を 調製し、これを用いて  $BaTiO_3$ ナノ粒子を合成することとした。

BaCO<sub>3</sub>粉体と平均粒径20nmの  $TiO_2$ 粉体を  $BaCO_3$ :  $TiO_2 = 1:1$ のモル比で秤量した。これらの粉末を、粒子複合化装置(ノビルタ NB-130(ホソカワミクロン㈱製))を用いて、5.0kW、10分保持の条件で機械的処理を行った。この混合粉体を、アルミナボートに載せて、大気中、 $700\sim900$ °C、30分保持の条件で焼成した。

混合粉末の SEM による微構造観察の結果、機械的 粒子複合化処理を行った混合粉体では、 $TiO_2$ ナノ粒 子の凝集体は観察されず、 $TiO_2$ は良好に分散してい ることが確認された(図10)。また、機械的処理前後 の粉末の構成相に変化は見られなかった。焼成後の試 料の XRD による構成相同定の結果、700℃で焼成し た試料は焼成前のものと同じ構成相であったが、800℃、30分保持の焼成では  $BaCO_3$ が少量残存している ものの、 $BaTiO_3$ が主相であることが確認された (図11)。また、900℃、30分保持では  $BaCO_3$ はほぼ消 失し、ほとんどが  $BaTiO_3$ に変化していた。 XRD プロファイルから算出した  $BaTiO_3$ の結晶子サイズは、約 20nm と見積もられた。これは TEM 観察の結果と良く対応しており、良好な結晶性も確認された(図12)。このように低温で  $BaTiO_3$ ナノ粒子が合成されたのは、 $TiO_2$ ナノ粒子の均一に分散に起因すると考えられる。

## 3. おわりに

機械的処理による微粒子複合化とそのセラミックスへの応用展開について概説した。その応用範囲は、今回のセラミックスに限らず多岐にわたると考えられる。接合メカニズムの解明、すなわち、学問分野としてのナノ接合科学なども含めて、今後のさらなる発展に期待したい。

#### 参考文献

- Naito, M., Kondo, A. and Yokoyama, T. (1993): Applications of Comminution Techniques for the Surface Modification of Powder Materials, ISIJ International, No. 33, pp. 915-924.
- 2) Tatami, J., Nakano, H., Wakihara T., Komeya, K., (2010): "Development of Advanced Ceramics by Powder Composite Process," KONA Powder and Particle Journal, No. 28, pp. 227-240.
- 3) 多々見純一,窒化ケイ素軸受材料(特集窒化ケイ素系材料:過去から未来へ),セラミックス,47,20-24(2012).
- 4) J. Tatami T. Katashima, K. Komeya, T. Meguro and T. Wakihara, Electrically Conductive CNTdispersed Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Ceramics, J. Am. Ceram. Soc., 88, 2889-2893, 10 (2005).
- 5) Hashimoto, A., Yoshio, S., Tatami, J., Nakano, H., Wakihara, T., Komeya, K., Meguro, T., (2011): "Fabrication of CNT-dispersed Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ceramics by mechanical dry mixing," Ceramic Engineering and Science Proceedings, Vol. 32 pp83-88.
- 6) Daisuke Hiratsuka, Junichi Tatami, Toru Wakihara, Katsutoshi Komeya and Takeshi Meguro, "Fabrication of AlN ceramics using AlN and nano-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> composite particles prepared by mechanical treatment" Key Engineering Materials, 403, 245-248 (2009).

7) Satoko Tasaki, Junichi Tatami, Hiromi Nakano, Toru Wakihara, Katsutoshi Komeya, Takeshi Meguro, "Fabrication of ZnO ceramics using ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanocomposite particles prepared by mechanical treatment", Journal of the Ceramic Society of Japan, FEB, 118, 118-121 (2010).

#### Captions

- Fig. 1 SEM and TEM images of TiO<sub>2</sub>-CNT nanocomposite particle prepared by mechanical treatment
- Fig.2 SEM image of the fracture surface of CNT-dispersed  $Si_3N_4$  ceramics sintered at  $1700^{\circ}C$  (CNT: 1.0wt%)
- Fig. 3 Microstructure of AlN-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> powder mixtures
- Fig. 4 Microstructure of AlN ceramics (Back scattered electron image (Composition image))
- Fig. 5 TEM photographs of  $\rm ZnO-Al_2O_3$  nanocomposite particles prepared by mechanical treatment. (b) is an enlarged view of (a)
- Fig. 6 Microstrucutre of 1.0 mol% $Al_2O_3$  doped ZnO ceramics prepared by (a) ball milling and (b) mechanical treatment
- Fig. 7 Microstrucutre of 0.1 mol%Al $_2$ O $_3$  doped ZnO ceramics prepared by (a) ball milling and (b) mechanical treatment
- Fig. 8 SEM photographs of  $Al_2O_3$ -phenol regin nanocomposite particles prepared by mechanical treatment
- Fig. 9 SEM photographs of porous Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramics prepared using nanocomposite particles.
  (b) is an enlarged view of (a)
- Fig. 10 SEM photographs of powder mixtures prepared by mechanical treatment and wet ball milling
- Fig. 11 XRD profiles of the raw powder mixtures and the products fired at various temperatures
- Fig. 12 TEM images of BaTiO<sub>3</sub> particles prepared using nanocomposite particles